

《光电子器件微波封装和测试》

图书基本信息

书名：《光电子器件微波封装和测试》

13位ISBN编号：9787030191984

10位ISBN编号：7030191986

出版时间：2007-7

出版社：科学出版社

作者：祝宁华

页数：292

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu000.com

《光电子器件微波封装和测试》

内容概要

《光电子器件微波封装和测试》重点讨论与光电子器件高速特性相关的芯片测试分析、器件微波封装、高频性能测试、等效电路分析模型、寄生参数的影响及器件封装优化设计等方面问题。对器件封装设计中的光耦合问题和热力学设计问题不作深入的介绍。但当光耦合和热力学设计结构的对器件高频特性有一定影响时，将结合高速光电子器件的微波封装进行综合讨论。

《光电子器件微波封装和测试》

作者简介

祝宁华，研究员，1978～1989年电子科技大学获学士、硕士和博士学位；1989～1990年中山大学从事博士后研究工作；1990～1994年在中山大学工作，1994年晋升为教授；1994～1995年香港城市大学研究员；1996～1998年德国西门子公司客座科学家（洪堡研究员）；1997年入选中国科学院“百人计划”进入中国科学院半导体研究所工作；1998年获杰出青年科学基金；2004年入选“新世纪百千万人才工程”国家级人选。在光波导器件的理论研究与优化设计，用于微波集成电路和光电集成器件的各种传输线的模拟分析，高速半导体激光器和调制器组件的研究开发方面都开展了卓有成效的工作。目前主持865项目，973课题，香港研究基金，基金委重大国际合作和重点项目，科技部重大国际合作等项目。申请发明专利25项，发表100多篇论文。

《光电子器件微波封装和测试》

书籍目录

“ 导半导体科学与技术丛书 ” 出版说明序前言第一章 绪论1.1 器件封装设计的重要性1.2 器件测试分析的意义1.3 本书主要涉及的器件的类型1.4 本书的特点第二章 高速半导体激光器的微波封装设计2.1 激光器封装类型2.2 微波设计和封装方法2.3 激光器等效电路模型2.4 集总参数和分布式模型2.5 “ 黑盒子 ” 式等效电路模型2.6 封装技术潜在带宽估计2.7 激光器封装的优化设计2.8 补偿技术思考题参考文献第三章 高速光调制器的微波封装设计3.1 铌酸锂光波导调制器3.2 电吸收光调制器3.3 电吸收光调制器的等效电路模型3.4 EML三端口等效电路模型的建立与分析3.5 封装的优化设计思考题参考文献第四章 高速半导体光探测器的封装设计4.1 封装类型4.2 微波设计和封装方法4.3 光探测器的等效电路模型4.4 封装潜在带宽研究4.5 封装的优化设计思考题参考文献第五章 小信号频率响应特性5.1 小信号与大信号频率响应5.2 常用的网络参数5.3 散射参数5.4 双端口级联网络的参数5.5 光电子器件S参数5.6 主要性能指标定义5.7 动态特性曲线思考题参考文献第六章 网络分析仪扫频测试方法6.1 测试方法优点与局限性6.2 校准的概念和测试夹具的设计6.3 校准过程中出现的问题.....第七章 调制器频率响应的小信号功率测试法第八章 光外差技术及其应用第九章 大信号响应特性测试方法第十章 光电子器件本征特性分析及其应用第十一章 光谱与频谱分析技术索引

《光电子器件微波封装和测试》

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:www.tushu000.com